

TOKYO PACK 2018

日時:2018年10月02日(火)~05日(金)

主催： 公益社団法人日本包装技術協会(Japan Packaging Institute)

協賛： 包装関連約 100 団体

後援： 経済産業省/日本商工会議所/日本貿易振興機構/日本生産性本部/世界包装機構/アジア包装連盟/日本包装機械工業会/日本マテリアル・ハンドリング(MH)協会/東京ビッグサイト

会場： 東京ビッグサイト(東京国際展示場) 東展示棟 1~6 ホール

テーマ：「考えよう 地球をまもるパッケージ」



10月02日(火)~05日(金)、東京ビッグサイトにて開催された「TOKYO PACK 2018/東京国際包装展」に出展しました。TOKYO PACK は、あらゆる業界で利用される包装資材・容器、包装機械を中心に、調達〜リサイクルに至る包装のすべてを網羅した世界有数の国際総合包装展です。1966年に第1回目が開催され、今回が27回目となります。

会場では、最新の包装技術やトレンドを発信する12ジャンルのセミナーと、日本パッケージングコンテストの入賞作品を一堂に展示する「2018グッドパッケージング展」、「『明治150年』と包装の歴史」など5つのイベントが開催されました。主催者の発表では来場登録者数は62,488人(前回62,171人)、のべ入場者数209,049人(前回182,677人)と、前回は上回る結果となりました。

KOMORI は本展示会への初めての参加となり、デジタル印刷機やデジタル後加工機の紹介、そして多彩なサンプル展示を中心に展示しました。また、国内シェア1位のオフセット印刷機メーカーであるKOMORI だけができる、パッケージ印刷業界への印刷ソリューションをご紹介しました。

ブースには多くのお客様が訪れ、特にハイコン社ユークリッド(デジタルカッティング・クリーニングシステム)による微細加工を生かしたデザインのグリーティングカードやハーフカットを施したシール、オフセット印刷の擬似エンボスサンプル、インプレミア IS29(29インチ枚葉UVインクジェットデジタルプリンティングシステム)によるバリエーション豊かな印刷パッケージなどを興味深くご覧になり、様々な質問をいただきました。

このたびはKOMORIブースにお越しいただき誠にありがとうございました。

KOMORI は常にお客様の立場から次世代を見据えた商品を提供し続け、パッケージ印刷産業においてもお客様の課題を解決するためのトータルなソリューションを提案してまいります。これからのKOMORIにもぜひご期待ください。

